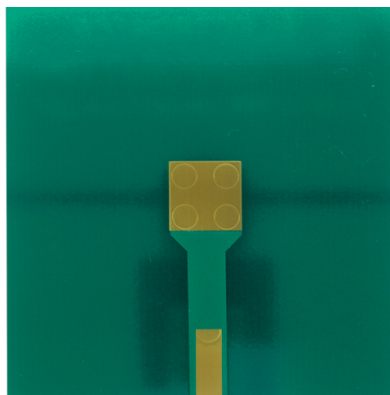
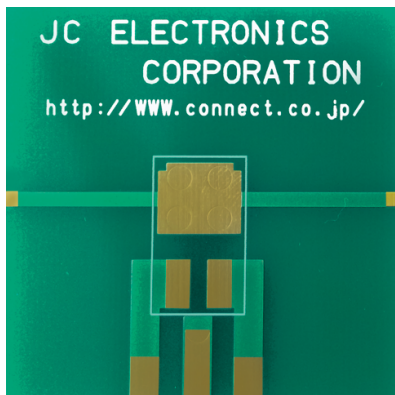


放熱VIA基板 Heat Dissipation Substrate

- ・軽量で高効率な排熱
- ・電源基板、車載、エネルギー関連等幅広い用途に使用可能
- ・高い放熱性

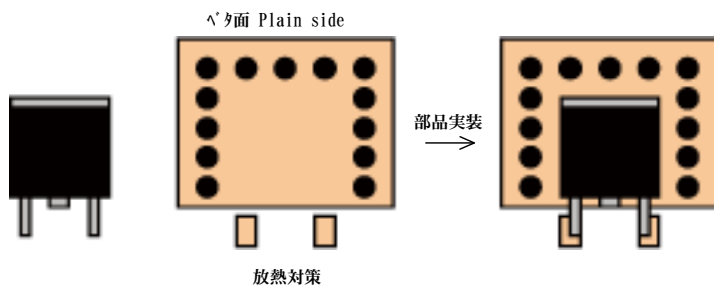
Light weight, high efficiency in heat exhaustion
 Applicable to a variety of purposes including Power Supply Board, In-vehicle equipments, and so on.
 High performance heat dissipation



性能 Performance

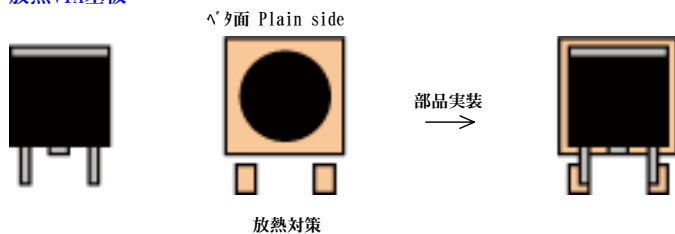
- 温度サイクル Temperature Cycle
 : -65±3℃ 30分
 125±3℃ 30分 500サイクル後
- ピン平坦性 Pin Flatness
 : 部品面側 +0.03~0.05mm以内
 半田面側 +0.1~0.05mm以内
- ピン保持 Pin Retention Force
 : 抜き落ちなし No falling out
- 前処理 Pre Processing
 : 温度40℃ 湿度90% 経過96Hr
 ※後リフロー2回
- リフロー耐性 Reflow Resistance
 : 導体浮き、層間剥離、膨れなし

従来の基板 Conventional Substrate



ベタ面スペースとVIAを打って放熱
 Heat is dissipated on the plain side and through Via hole.

放熱VIA基板



小スペースで放熱効果、電流も流せます。
 通常ビア φ1.5...1.5A
 銅ピン埋め φ1.5...10A流すことが可能
 Efficiency in heat dissipation with small footprint, electrical current can be applied.
 Ordinary Via φ1.5mm...1.5A
 Filling in with Copper Pin φ1.5mm...10A can be applied.

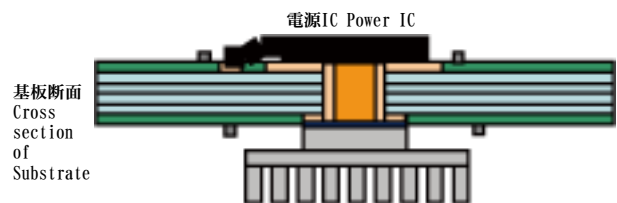


Components mounting side

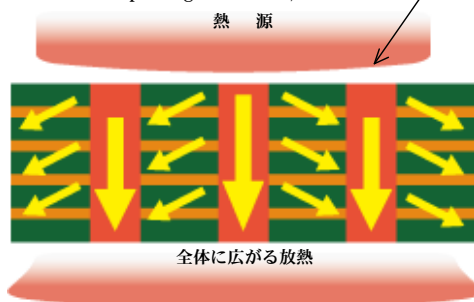
ヒートシンクとの組合せでより放熱効果が得られます。



Soldering side



放熱VIA基板の放熱イメージ
 Image View (Heat dissipation VIA Substrate is dissipating the heat)



熱拡散シートと銅を積層。
 熱伝導率 1700w/m·k 比重2.1g/cm³
 アルミに対して約8倍、銅に対して約4倍の熱伝導率
 Heat diffusion sheet and copper are laminated.
 Thermal Conductivity 1700w/m·k
 Proportion 2.1g/cm³
 (8 times higher than aluminum, 4 times higher than copper in thermal conductivity)